



ASSEMBLY

标记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION			修改 REVISE	日期 DATE	核准 APPROVE		
	高 photolithography (H)	母座 seat height (H1)	公座 seat height (H2)				插入 height (H3)	No. of Contacts
		A±0.10	B±0.10	C±0.10	D±0.10	E±0.10		
4.0	3.0	1.0	1.9	6	4.30	1.60	3.40	2.60
4.5	3.5	1.0	1.9	8	5.10	2.40	4.20	3.40
5.0	3.0/4.0	2.0/1.0	1.9	10	5.90	3.20	5.00	4.20
5.5	3.5/4.5	2.0/1.0	1.9	12	6.70	4.00	5.80	5.00
6.0	4.0	2.0	1.9	14	7.50	4.80	6.60	5.80
6.5	4.5	2.0	1.9	16	8.30	5.60	7.40	6.60
7.0	3.0	4.0	1.9	18	9.10	6.40	8.20	7.40
7.5	3.5	4.0	1.9	20	9.90	7.20	9.00	8.20
8.0	4.0	4.0	1.9	22	10.70	8.00	9.80	9.00
8.5	4.5	4.0	1.9	24	11.50	8.80	10.60	9.80
				26	12.30	9.60	11.40	10.60
				28	13.10	10.40	12.20	11.40
				30	13.90	11.20	13.00	12.20
				32	14.70	12.00	13.80	13.00
				34	15.50	12.80	14.60	13.80
				36	16.30	13.60	15.40	14.60
				38	17.10	14.40	16.20	15.40
				40	17.90	15.20	17.00	16.20

技术指标:

1. 工作温度: -25°C ~ +85°C
2. 额定电流: 0.5A Max
2. 接触电阻: 60mΩ Max
3. 绝缘阻抗: 800MΩ Min
4. 耐电压: 500V AC/1minute

2	端子	铜	镀金	
1	基座	PA9T	黑色	公座
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注


**深圳市虹成电子有限公司**  
 品名 TITLE: 板对板  
 料号 PART NO: HC-BTB-0.8-2x10P-GH40-W  
 GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED):  
 比列 SCALE: 1:1  
 单位 UNIT: MM  
 张数 PART NO: 1 OF 1  
 版本 REV: A  
 制图 DRAW: AhYe  
 审核 CHECKED: 夏操云  
 批准 APPROVE: 赵亮亮

